

# EC25-J MINIPCIE

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、EC25-J MINIPCIEのご紹介です。



## EC25-J MINIPCIE

Quectel社製  
LTE Cat.4/3G対応 汎用モジュール  
(Mini PCI Express Type)



## 特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・SoftBank 4G 対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応
- ・GPS対応
- ・音声対応

## スペック

製品名	EC25-J MINIPCIE
サイズ	51x30x4.9 [mm] (H×W×D)
重量	9.8g
通信方式	FDD-LTE/TDD-LTE/W-CDMA
周波数	LTE : B1/B3/B8/B41 3G : B1/B8
通信速度	LTE : Category4 3G : HSPA+
電源電圧	DC 3.0~3.6V
消費電流	通信時 約730mA 待受時 約26mA
外部インターフェース	(U)SIM/USB/UART/PCM/I2C/GPIOs
アンテナコネクタ	MAIN,DRX,GNSS
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度: -35°C~+75°C 保存温度: -40°C~+90°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はQuectel Wireless Solutions社が製造し、加賀デバイス株式会社より販売いたします。

※ 利用されるエリアによって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。